

2023年度 第3四半期 決算説明資料

マクニカホールディングス株式会社

2024年1月29日

2023年度 第3四半期 業績ハイライト

単位：億円	第3四半期				4-12月累積			通期見込み	
	実績	前年同期比	前四半期比		実績	前年同期比	見込み	進捗率	
売上高	2,533	▲221 ▲8%	▲151 ▲6%		8,003	+323 +4%	11,000	73%	
半導体事業	2,210	▲300 ▲12%	▲214 ▲9%		7,136	+163 +2%	10,000	71%	
ネットワーク事業	323	+79 +32%	+63 +24%		867	+160 +23%	1,000	87%	
営業利益	133	▲52 ▲28%	▲40 ▲23%		513	+60 +13%	660	78%	
半導体事業	115	▲55 ▲32%	▲47 ▲29%		461	+53 +13%			
ネットワーク事業	18	+3 +14%	+7 +58%		52	+7 +15%			
親会社株主に帰属する純利益	93	▲32 ▲26%	▲30 ▲24%		352	+59 +20%	422	83%	
営業キャッシュフロー					370	223 +152%			
平均為替レート（¥/USD）	149.09円				142.16円		140円（第4四半期）		

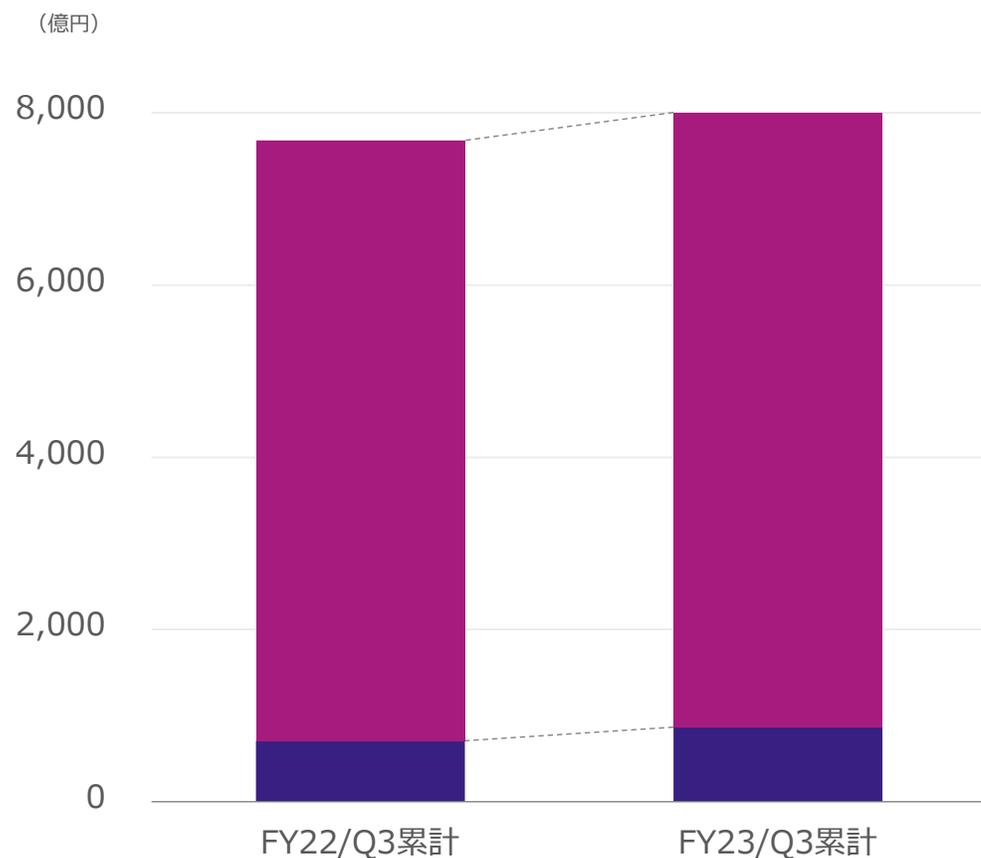
- 第3四半期累計期間は、半導体事業では調整局面となり、ネットワーク事業は国内・海外ともに好調を維持
半導体は、注力市場である産業機器、車載向けがそれぞれ+388億/+13%、+297億/+24%（売上高/前年同期比）と大きく伸び、メモリ中心の通信インフラ向けのマイナス成長をカバー。
- 第4四半期は、半導体事業は中国市場の低迷やメモリ分野の回復遅れなど調整局面が続く見込み、ネットワーク事業はセキュリティを中心に国内・海外共に好調を維持。
- 2023年度通期連結業績予想数値は、据え置いた一方、期末配当の予想を上方修正。

配当の状況（一株当たり）

	中間	期末	年間
2022年度	65円	75円	140円
2023年度（予想）	80円	110円	190円
配当性向（予想）			27%

セグメント別：売上高

8,003億円 前年同期比+4.2%

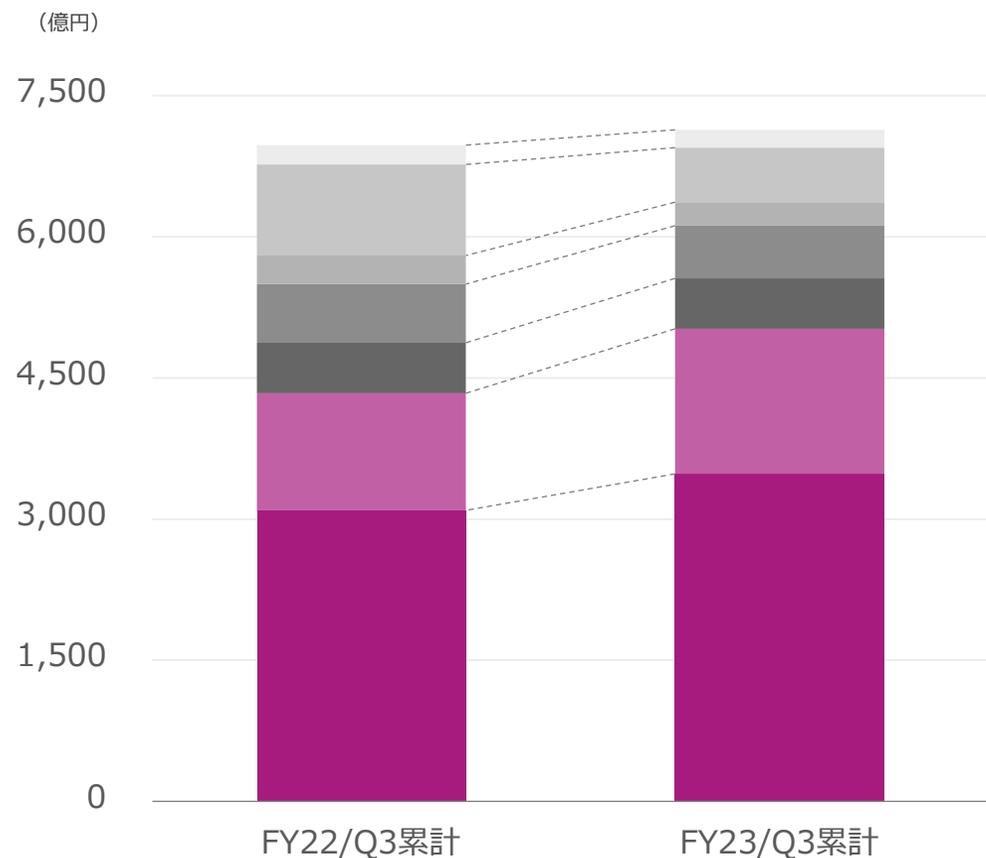


前年同期比+4.2%

	FY22/4-12月累計		FY23/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
(単位：億円)						
半導体	6,973	91%	7,136	89%	+163	+2%
ネットワーク	707	9%	867	11%	+160	+23%
合計	7,680	100%	8,003	100%	+323	+4.2%

半導体事業（用途別）：売上高

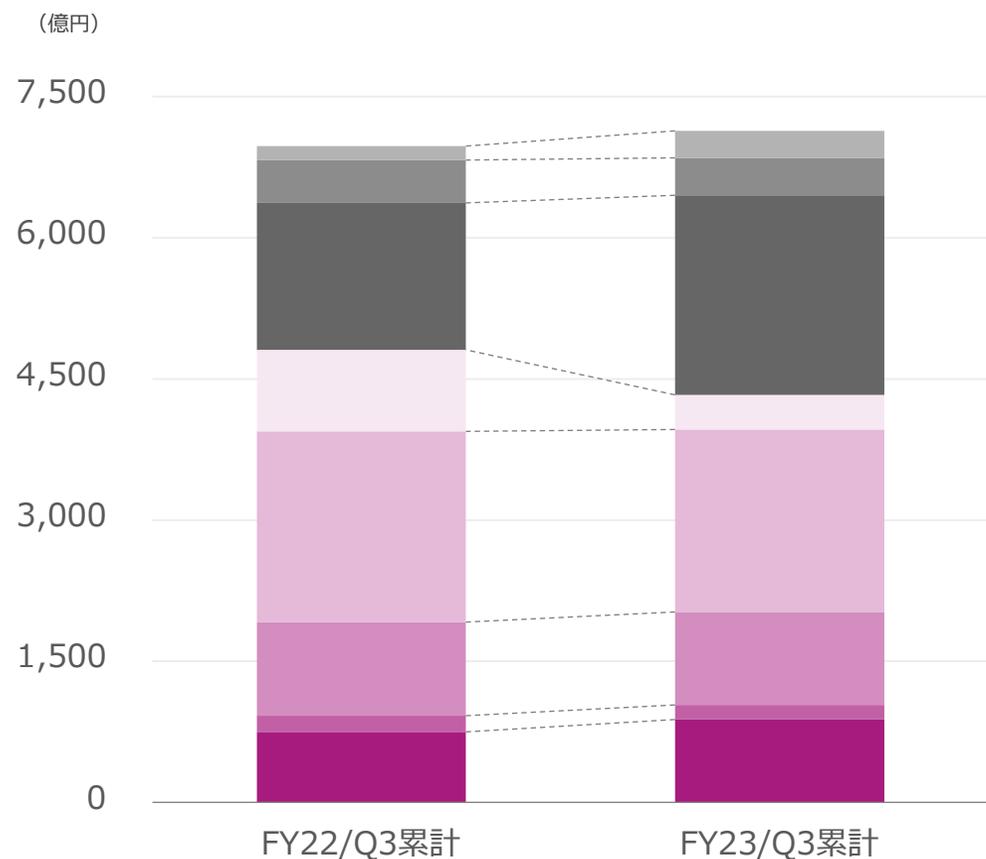
7,136億円 前年同期比+2.3%



(単位：億円)	FY22/4-12月累計		FY23/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
通信端末	205	3%	188	3%	▲17	▲8%
通信インフラ	967	14%	580	8%	▲387	▲40%
OA・周辺機器	303	4%	250	3%	▲53	▲18%
コンピュータ	625	9%	558	8%	▲67	▲11%
民生機器	537	8%	539	7%	+2	+0%
車載	1,242	18%	1,539	22%	+297	+24%
産業機器	3,094	44%	3,482	49%	+388	+13%
合計	6,973	100%	7,136	100%	+163	+2.3%

半導体事業（品目別）：売上高

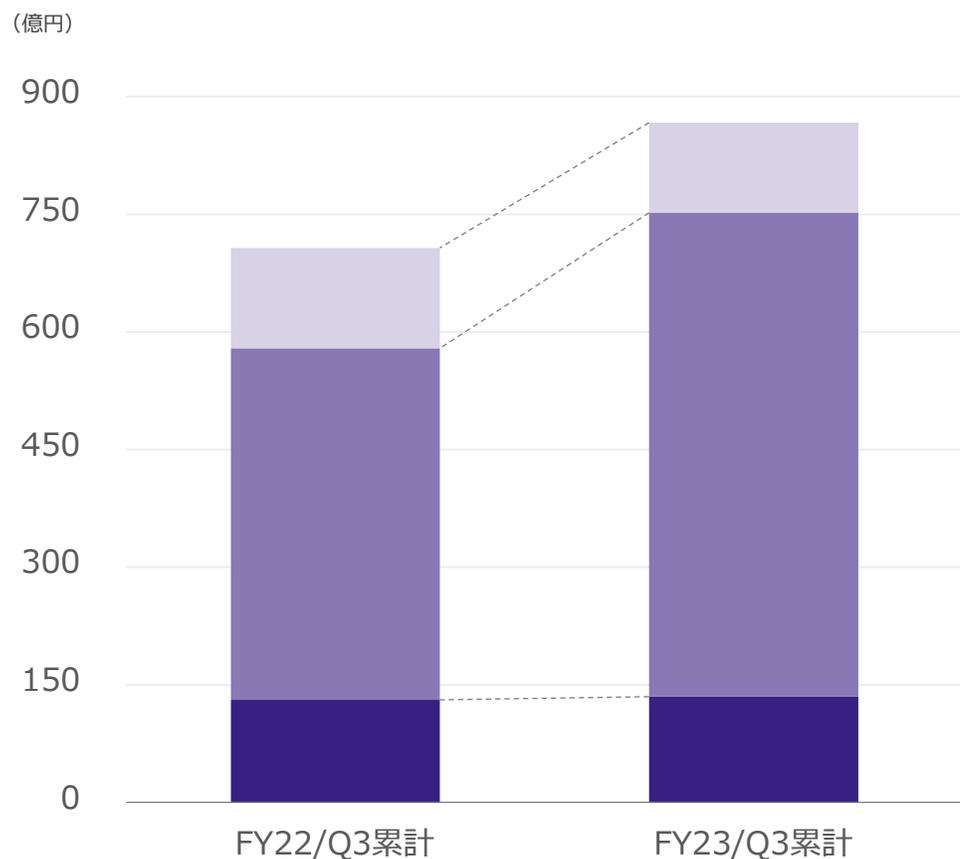
7,136億円 前年同期比+2.3%



(単位：億円)	FY22/4-12月累計		FY23/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
その他	147	2%	286	4%	+139	+95%
電子デバイス	456	7%	397	6%	▲59	▲13%
その他標準IC	1,560	22%	2,122	30%	+562	+36%
メモリー	868	12%	367	5%	▲501	▲58%
アナログ	2,026	29%	1,940	27%	▲86	▲4%
ASSP	994	14%	989	14%	▲5	▲1%
ASIC	172	3%	153	2%	▲19	▲11%
PLD	750	11%	882	12%	+132	+18%
合計	6,973	100%	7,136	100%	+163	+2.3%

ネットワーク事業（品目別）：売上高

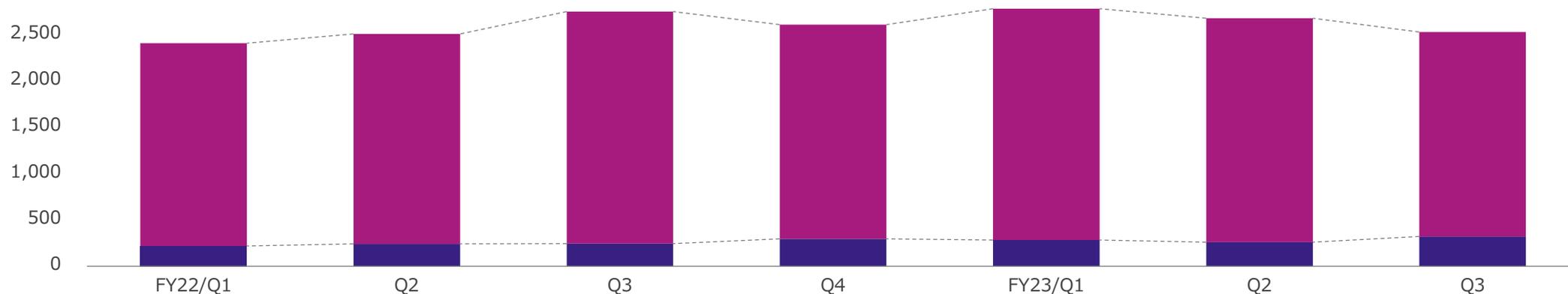
867億円 前年同期比+22.6%



(単位：億円)	FY22/4-12月累計		FY23/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
ハードウェア	128	18%	115	13%	▲13	▲10%
ソフトウェア	448	63%	617	71%	+169	+38%
サービス	131	19%	135	16%	+4	+3%
合計	707	100%	867	100%	+160	+22.6%

四半期推移 セグメント別：売上高

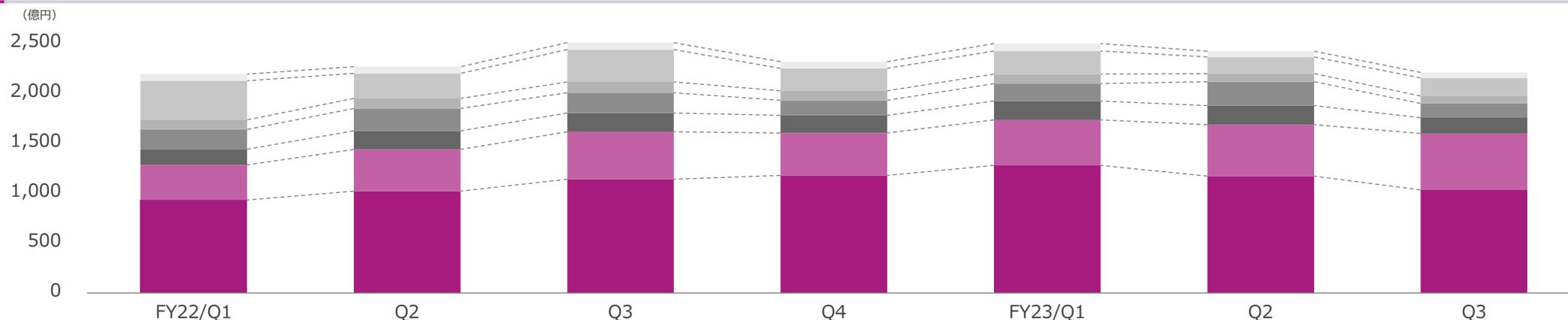
(億円)



実績 構成比 (億円 %)	セグメント	FY22/Q1		Q2		Q3		Q4		FY23/Q1		Q2		Q3	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
実績 構成比 (億円 %)	半導体	2,193	91%	2,270	90%	2,510	91%	2,317	89%	2,501	90%	2,424	90%	2,210	87%
	ネットワーク	220	9%	242	10%	244	9%	296	11%	284	10%	260	10%	323	13%

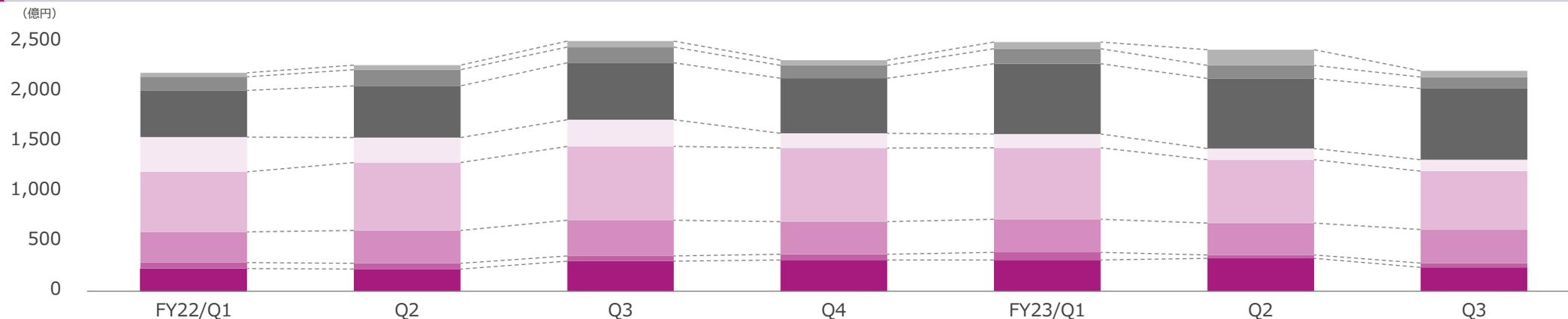
前年比 前期比	セグメント	FY22/Q1		Q2		Q3		Q4		FY23/Q1		Q2		Q3	
		増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比
前年比 前期比	半導体	+38%	22%	+37%	+4%	+45%	+11%	+28%	▲8%	+14%	+8%	+7%	▲3%	▲12%	▲9%
	ネットワーク	+18%	▲9%	+27%	+10%	+14%	+1%	+22%	+21%	+29%	▲4%	+7%	▲9%	+32%	+24%

四半期推移 半導体事業（用途別）：売上高



実績 構成比 (億円 %)	FY22/Q1		Q2		Q3		Q4		FY23/Q1		Q2		Q3		
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	
通信端末	67	3%	68	3%	70	3%	65	3%	75	3%	59	2%	55	2%	
通信インフラ	391	18%	252	11%	324	13%	225	10%	232	9%	166	7%	182	8%	
OA・周辺機器	95	4%	100	4%	108	4%	96	4%	95	4%	81	3%	74	3%	
コンピュータ	199	9%	225	10%	202	8%	152	7%	175	7%	241	10%	143	6%	
民生機器	159	7%	187	8%	190	8%	176	8%	189	8%	191	8%	159	7%	
車載	350	16%	417	18%	475	19%	426	18%	457	18%	516	21%	566	26%	
産業機器	933	43%	1,021	45%	1,141	45%	1,178	51%	1,278	51%	1,171	48%	1,033	47%	
前年比 前期比	通信端末	+28%	+28%	+26%	+2%	+16%	+3%	+24%	▲7%	+12%	+16%	▲14%	▲22%	▲22%	▲7%
	通信インフラ	+65%	+50%	▲9%	▲36%	+24%	+29%	▲14%	▲31%	▲41%	+4%	▲34%	▲29%	▲44%	+10%
	OA・周辺機器	+32%	+17%	+34%	+6%	+34%	+8%	19%	▲11%	+1%	▲1%	▲19%	▲15%	▲32%	▲9%
	コンピュータ	+5%	▲13%	+24%	+13%	▲3%	▲10%	▲34%	▲25%	▲12%	+15%	+7%	+38%	▲29%	▲41%
	民生機器	+6%	+19%	+27%	+18%	+41%	+2%	+32%	▲8%	+19%	+7%	+2%	+2%	▲16%	▲17%
	車載	+49%	+27%	+75%	+19%	+88%	+14%	+54%	▲10%	+31%	+7%	+24%	+13%	+19%	+10%
	産業機器	+42%	+21%	+50%	+10%	+56%	+12%	+53%	+3%	+37%	+9%	+15%	▲8%	▲9%	▲12%

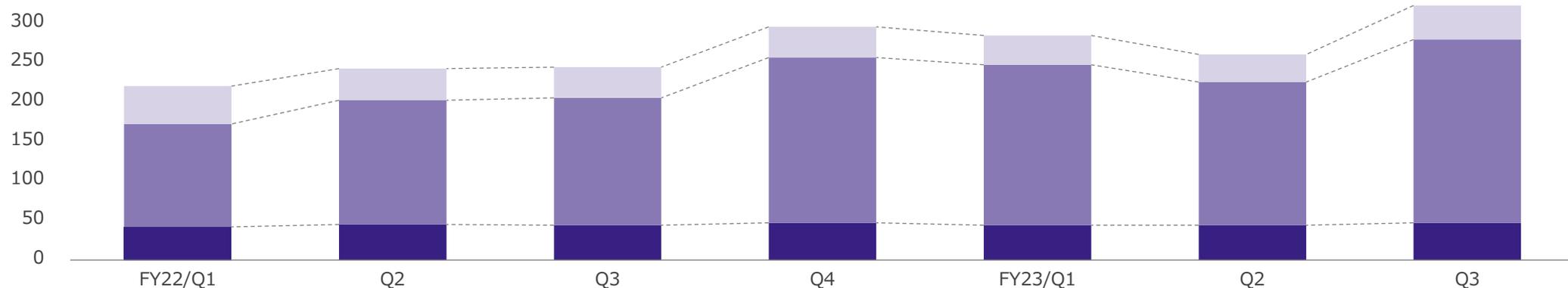
四半期推移 半導体事業（品目別）：売上高



		FY22/Q1		Q2		Q3		Q4		FY23/Q1		Q2		Q3	
実績 構成比 (億円 %)	その他	40	2%	46	2%	61	2%	52	2%	67	3%	157	6%	62	3%
	電子デバイス	136	6%	163	7%	157	6%	129	6%	151	6%	131	5%	115	5%
	その他標準IC	469	21%	520	23%	571	23%	552	24%	704	28%	703	29%	715	32%
	メモリー	350	16%	250	11%	268	11%	148	6%	139	6%	113	5%	115	5%
	アナログ	602	27%	682	30%	742	30%	739	32%	718	29%	636	26%	587	27%
	ASSP	307	14%	329	15%	358	14%	328	14%	332	13%	320	13%	337	15%
	ASIC	61	3%	57	3%	54	2%	57	2%	76	3%	35	1%	41	2%
	PLD	227	10%	223	10%	300	12%	313	14%	313	13%	329	14%	240	11%
前年比 前期比	その他	+19%	+18%	+59%	+13%	+55%	+33%	+53%	▲14%	+67%	+29%	+245%	+134%	+2%	▲61%
	電子デバイス	+31%	+27%	+94%	+20%	+67%	▲4%	+20%	▲18%	+11%	+17%	▲20%	▲13%	▲27%	▲12%
	その他標準IC	+38%	+11%	+46%	+11%	+46%	+10%	+30%	▲3%	+50%	+28%	+35%	▲0%	+25%	+2%
	メモリー	+40%	+11%	▲17%	▲29%	▲12%	+7%	▲53%	▲45%	▲60%	▲6%	▲55%	▲19%	▲57%	+2%
	アナログ	+38%	+29%	+57%	+13%	+60%	+9%	+58%	▲0%	+19%	▲3%	▲7%	▲11%	▲21%	▲8%
	ASSP	+36%	+33%	+46%	+7%	+73%	+9%	+42%	▲8%	+8%	+1%	▲3%	▲4%	▲6%	+5%
	ASIC	+118%	+63%	+17%	▲6%	+29%	▲7%	+51%	+6%	+25%	+35%	▲38%	▲54%	▲24%	+15%
	PLD	+31%	+22%	+29%	▲2%	+56%	+35%	+68%	+4%	+38%	+0%	+48%	+5%	▲20%	▲27%

四半期推移 ネットワーク事業（品目別）：売上高

(億円)



実績 構成比 (億円 %)	品目	FY22/Q1		Q2		Q3		Q4		FY23/Q1		Q2		Q3	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
実績 構成比 (億円 %)	ハードウェア	48	22%	40	17%	39	16%	39	13%	37	13%	35	13%	43	13%
	ソフトウェア	130	59%	157	65%	161	66%	209	71%	203	71%	181	70%	232	72%
	サービス	42	19%	45	18%	44	18%	47	16%	44	15%	44	17%	47	15%

前年比 前期比	品目	FY22/Q1		Q2		Q3		Q4		FY23/Q1		Q2		Q3	
		増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	
前年比 前期比	ハードウェア	+13%	+6%	▲9%	▲17%	▲13%	▲2%	▲14%	▲0%	▲23%	▲5%	▲13%	▲7%	+8%	+22%
	ソフトウェア	+56%	▲1%	+76%	+22%	+51%	+2%	+61%	+30%	+57%	▲3%	+15%	▲11%	+45%	+28%
	サービス	▲30%	▲36%	▲20%	+6%	▲29%	▲1%	▲29%	+6%	+4%	▲7%	▲2%	+0%	+7%	+8%

MACNICA